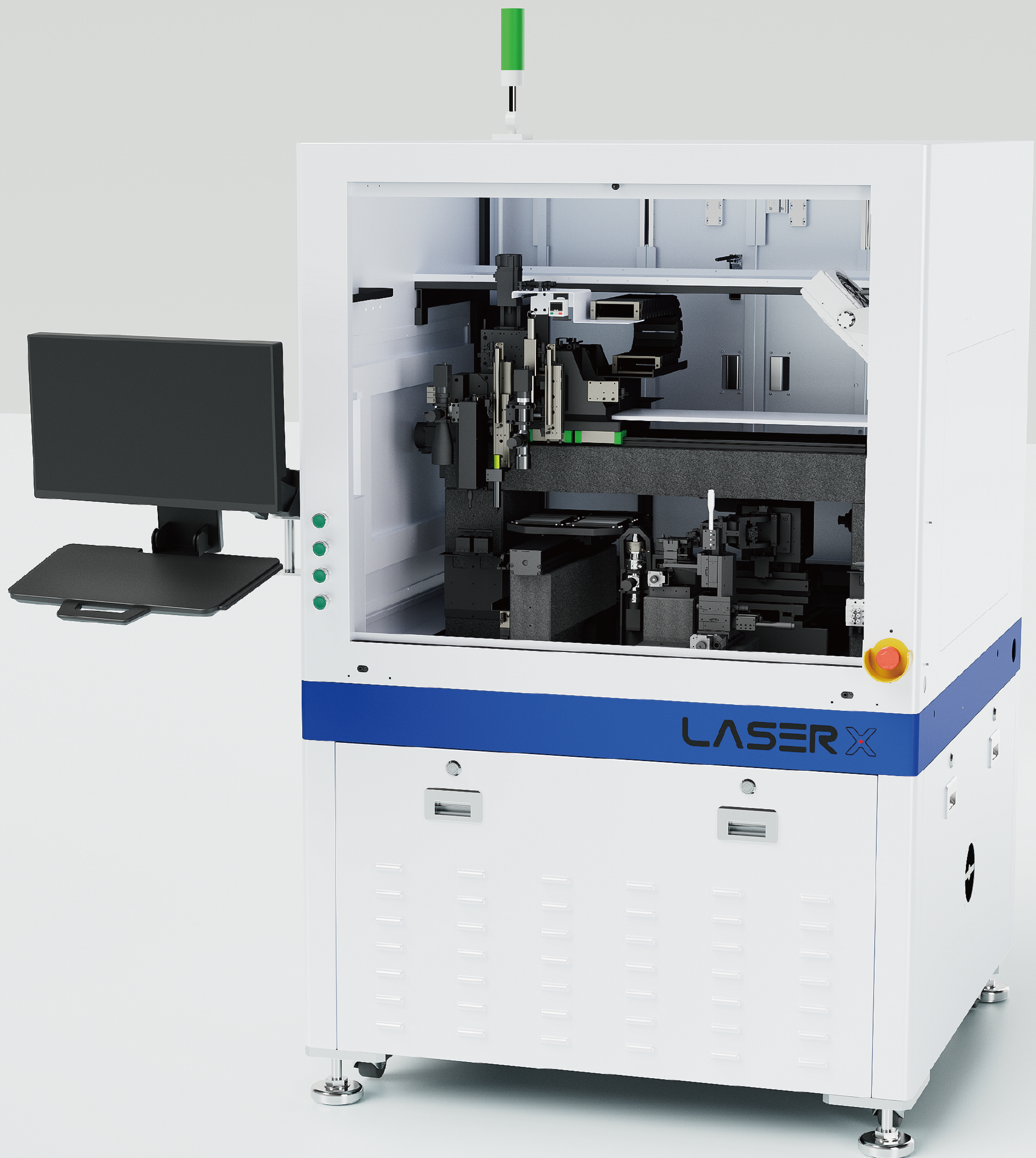




芯片耦合测试机

产品特性

| 项目            | 指标 / 特点             |
|---------------|---------------------|
| 产品            | 支持硅光，薄膜铌酸锂          |
|               | 蓝膜，单DIE，Bar条        |
| 上下料方式         | 全自动上下料              |
| 温度范围          | 25℃~80℃             |
| 升温时间(25℃~80℃) | 1.5分钟               |
| 降温时间(80℃~25℃) | 1.5分钟               |
| 耦合指标          | 光学耦合<30s（U Loop）    |
|               | 耦合重复精度 < 0.2dB      |
|               | 光功率稳定性 < 0.2dB@3min |
| 耦合方式          | 单/双FA耦合，端面耦合，垂直耦合   |
| 设备功能          | 高精度扎针系统，自动扎针        |
|               | 直线电机耦合系统，全自动耦合      |
|               | 自动点光学胶              |
|               | 自动清针                |
|               | 自动分Bin              |
|               | OCR识别               |
|               | MES对接和数据自动上传        |